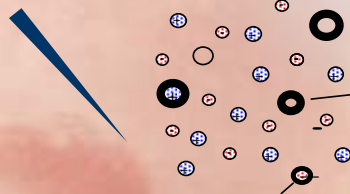




IL PLASMA è un gas contenente specie chimicamente attive e specie cariche

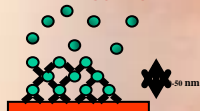


Induce **Processi chimici fisici su scala nanometrica** a temperatura ambiente



I processi a plasma

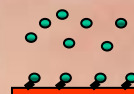
FILM DEPOSITION



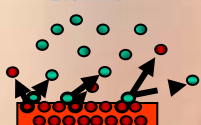
▫ **Deposizione di film sottili**, di natura organica (simili ai polimeri convenzionali) od inorganica (ossidi di vari metalli e semiconduttori).

▫ **Innesto di specifici gruppi funzionali** per superfici con specifiche affinità (a resine, a coloranti, a coating, ...)

GRAFTING



ETCHING



▫ **Ablazione**, ovvero rimozione di strati superficiali di materiali inorganici ed organici, per modificarne la morfologia, (microelettronica).

▫ **Attivazione e/o reticolazione** per controllare la reattività a specifici ambienti.

Activation



I vantaggi della tecnologia

Per l'innovazione:

- genera materiali innovativi e nuove proprietà di superficie
- non modifica le proprietà di volume del materiale

Per l'ambiente:

- quantità di prodotti chimici trascurabile
- favorisce il riciclo
- processo che non utilizza acqua

